

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成

[公開編] 平成 15 年 ~ 平成 19 年 (5 年間) 62 点

(税込価格)

(本体価格)

全文 P D F	CD-ROM 版 (抄録版付)	¥ 26,250 -	¥ 25,000 -
全文紙収録	B 5 製本版	¥ 26,250 -	¥ 25,000 -
(CD-ROM版・B 5 製本版 一括購入		¥ 38,850 -	¥ 37,000 -)

既刊 関連 セットの ご 案内

(本体価格)

No.	公開特許	既刊 関連 セットの ご 案内	点	(本体価格)
No, 9998	公開特許	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	100点 ¥29,600
No, 9189	"	"	平.10-12	68点 ¥24,800
No, 8533	"	"	平.7-9	67点 ¥26,700
No, 7798(B)	"	"	平.3-6	51点 ¥19,800
No, " (A)	"	"	昭.62-平.2	46点 ¥17,900
No, 10153	"	バレルメッキ方法と装置	平.17-18	82点 ¥24,600
No, 9798	"	"	平.15-16	74点 ¥19,700
No. 9463	"	"	平.13-14	70点 ¥16,100
No. 9069	登録・公開	"	平.11-12	68点 ¥26,600
No. 8579	"	"	平.9-10	76点 ¥30,000
No, 8084	公告・公開	"	平.7-8	73点 ¥29,700
No, 7797	"	"	平.5-6	66点 ¥23,000
No, 7558	"	"	平.3-4	109点 ¥39,200
No, 10054	公開特許	電気めっき用治具とめっき方法	平.17-18	68点 ¥23,800
No, 9797	"	"	平.15-16	68点 ¥18,400
No, 9464	"	"	平.13-14	68点 ¥16,100
No. 9241	"	"	平.11-12	67点 ¥20,000
No. 8641(B)	"	"	平.8-10	90点 ¥31,000
No. " (A)	"	"	平.5-7	91点 ¥31,300
No. 9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点 ¥27,400
No. 9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	70点 ¥27,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版は P D F ファイルにしおりリンク機能、B 5 製本版は B 5 サイズ・目次製本済みです。

2 ~ 3 日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No, _____ CD-ROM版・B 5 製本版・一括購入
所属部署	題 名

担当者名	E-mail

	() Fax ()
住所 〒	_____

料金には別途送料がかかります。

無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成

No.10199

[公開編] 平成15年～平成19年(5年間) 62点

CD-ROM版 ¥26,250

B5製本版 ¥26,250

(全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥38,850)

- | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 めっき方法 | シップレーカンパニー エル エル シー | 32 スズ又はスズ合金メッキ方法 | 石原薬品株式会社 |
| 2 前処理によるスズホイスカーの防止方法 | 石原薬品株式会社 | 33 金属処理のためのポリマー誘導体 | ビーイーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト |
| 3 電子部品の製造方法、及び電子部品 | 株式会社村田製作所 | 34 スズ電着物におけるホイスカー成長の最小化 | テクニク・インコーポレーテッド |
| 4 ヒートパイプ | 日立電線株式会社 | 35 無電解堆積法 | アブライド マテリアルズ インコーポレイテッド |
| 5 半導体チップ実装用回路基板とその製造方法および半導体モジュール | イビデン株式会社 | 36 ウィスカー成長が抑制されたスズ系めっき皮膜及びその形成方法 | 永保化工(香港)有限公司 |
| 6 電子部品のめっき方法、及び電子部品 | 株式会社村田製作所 | 37 電子部品の製造方法 | 日本無線株式会社 |
| 7 半導体チップ実装回路基板とその製造方法および多層化回路基板 | イビデン株式会社 | 38 ウィスカ形成傾向の少ないスズ被覆プリント配線基板 | オルメコン・ゲーエムベーハー |
| 8 新規なチップ相互配線およびパッケージング堆積方法および構造体 | ナトゥール・インコーポレイテッド | 39 プリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 9 誘電構造物 | シップレーカンパニー エル エル シー | 40 コンタクト及びそれを用いたコネクタ、並びにコンタクトの製造方法 | 日本航空電子工業株式会社 |
| 10 配線基板、及び、配線基板の製造方法 | 日本特殊陶業株式会社 | 41 防止剤およびこれを用いるウィスカー防止方法 | 荏原ユーージャイト株式会社 |
| 11 スズ - 銀系無鉛はんだ | 三井金属鉱業株式会社 | 42 耐熱性絶縁樹脂の金属めっき方法 | 荏原ユーージャイト株式会社 |
| 12 スズホイスカーの防止方法 | 石原薬品株式会社 | 43 表面処理Al板 | 東洋鋼鋳株式会社 |
| 13 スズメッキ方法 | シップレーカンパニー エル エル シー | 44 ナノダイヤモンド粒子含有めっき膜を形成した材料及びその製造方法 | 国立大学法人長岡技術科学大学 |
| 14 メッキ法 | シップレーカンパニー エル エル シー | 45 半導体装置の製造方法、および半導体基板のめっき装置 | NECエレクトロニクス株式会社 |
| 15 スズコート銅粉並びにそのスズコート銅粉の製造方法及びそのスズコート銅粉を用いた導電性ペースト | 三井金属鉱業株式会社 | 46 被メッキ樹脂組成物及びメッキ被覆体 | ダイセルポリマー株式会社 |
| 16 二層コート銅粉並びにその二層コート銅粉の製造方法及びその二層コート銅粉を用いた導電性ペースト | 三井金属鉱業株式会社 | 47 浸漬方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー |
| 17 無電解スズ系メッキの前処理方法、及びスズ系メッキ皮膜の異常析出防止方法 | 石原薬品株式会社 | 48 表面処理Al板 | 東洋鋼鋳株式会社 |
| 18 光ファイバアレイの製造方法 | 住友金属鉱山株式会社 | 49 シアン化物非含有銀系メッキ浴、メッキ体及びメッキ方法 | 石原薬品株式会社 |
| 19 メッキ表面の後処理液、及び後処理方法 | 石原薬品株式会社 | 50 外部接続端子 | 富士通株式会社 |
| 20 メッキ前処理液およびメッキ前処理方法 | 三井金属鉱業株式会社 | 51 半導体チップ実装用回路基板 | イビデン株式会社 |
| 21 メッキ表面の後処理液、及び後処理方法 | 石原薬品株式会社 | 52 Cuコアボールとその製造方法 | 新日鉄マテリアルズ株式会社 |
| 22 銅表面の対樹脂接着層 | メック株式会社 | 53 半導体モジュール | イビデン株式会社 |
| 23 非水電池用負極及びそれを用いる非水電池と負極活物質の製造方法 | 日産自動車株式会社 | 54 誘電体の金属化 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー |
| 24 めっき溶液の再生方法 | アトーテヒ ドイツチュラントゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 55 光輝性複合構造体およびその製造法 | 帝人ファイバー株式会社 |
| 25 非水電解液二次電池用負極及び非水電解液二次電池 | 三井金属鉱業株式会社 | 56 鉛蓄電池用極板群の製造方法および前記極板群を用いた鉛蓄電池 | 古河電池株式会社 |
| 26 メッキ表面の後処理液、及び後処理方法 | 石原薬品株式会社 | 57 配線基板 | 三井金属鉱業株式会社 |
| 27 リチウム二次電池用負極 | 株式会社大和化成研究所 | 58 接触センサ用電極 | 日本セラミック株式会社 |
| 28 非導電性基体を金属化する方法およびそれにより形成される金属化非導電性基体 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー | 59 めっき液および導電性素材の製造方法 | TDK株式会社 |
| 29 配線基板の製造方法 | 日本特殊陶業株式会社 | 60 スズめっき皮膜の形成方法および半導体装置 | 住友金属鉱山株式会社 |
| 30 金属膜形成方法 | JSR株式会社 | 61 メッキ製品の製造方法 | オーエム産業株式会社 |
| 31 配線基板及び半田部材付き配線基板 | 日本特殊陶業株式会社 | | |

以下1点省略